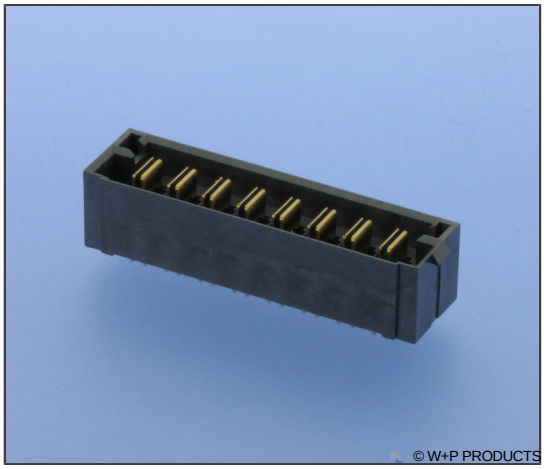
452

Power-Terminal RM 5,00mm, Stiftkontakte, gerade

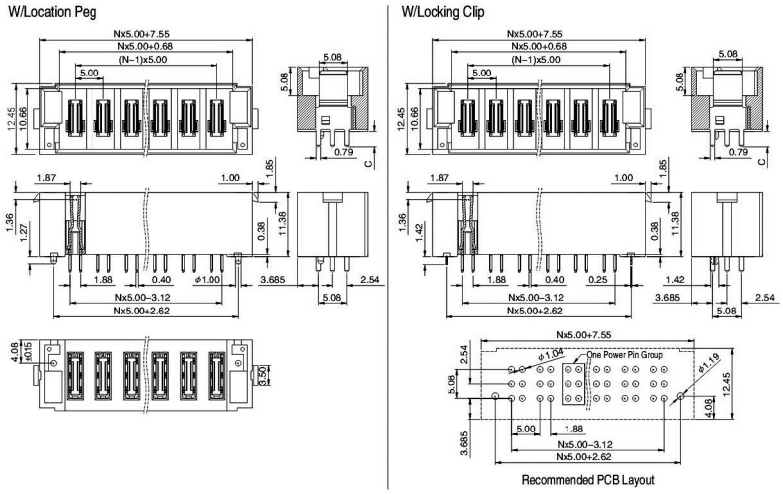
Power-Terminal 5.00mm Pitch, Male, Straight

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to plating options, over Ni*
Nennspannung	600 V AC / 848 V DC
Voltage Rating	*600 V AC / 848 V DC*
Nennstrom	24,7 A
Current Rating	*24.7 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +105 °C (Sn Veredelung)
	-55° ... +125 °C (Au Veredelung)
Temperature Range	*-55° ... +105 °C (Sn plating)*
	-55° ... +125 °C (Au plating)
Verarbeitung	260 °C für 10s
Processing	*260 °C for 10s*



Gegenstecker / *Mating Connectors* : **450**, **451**



Series	*Contacts* *	*Terminal Type* *	*Plating* *	*Locating Option* *	*Packaging* *
452	**06**	**12**	**00**	**10**	**ST**
	02/03/04/06/08	**10** C=2.72mm **11** C=3.52mm **12** C=4.32mm	**00** Au flash **50** Sn **60** Sel. Au/Sn **610** Sel. Au 10µ"/Sn	**10** Locating Pegs **20** Locking Clips	**ST** **TRAY**

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Lieferformen / *Packaging Options:*
ST In Stangen / *In tubes*
TRAY Auf Tray / *On tray*

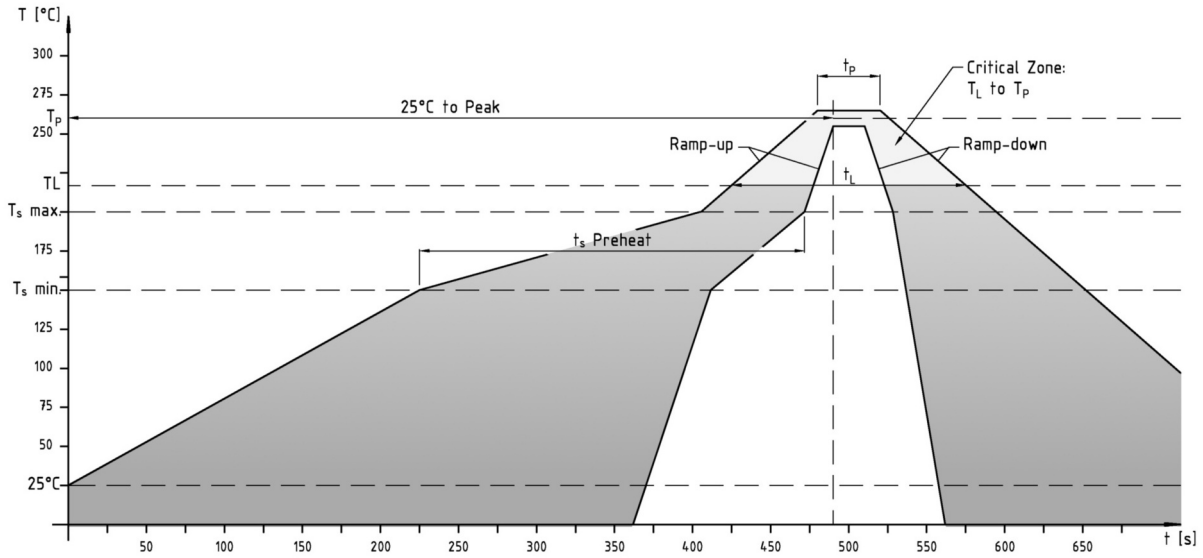
Informationen zum Reflow-Lötverfahren
Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*